

CEI 60749-32
(Première édition – 2002)

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –**

**Partie 32: Inflammabilité des dispositifs à
encapsulation plastique (cas d'une cause
extérieure d'inflammation)**

IEC 60749-32
(First edition – 2002)

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

**Part 32: Flammability of plastic-encapsulated
devices (externally induced)**

CORRIGENDUM 1

Page 4

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de
cette publication ne sera pas modifié
avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de
cette publication ne sera pas modifié
avant 2007.

Page 5

Instead of:

The committee has decided that the
contents of this publication will remain
unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the
contents of this publication will remain
unchanged until 2007.

[IEC 60749-32:2002/COR1:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/ce99db54-4d59-4864-bbc8-cd4f1a28d18b/iec-60749-32-2002-cor1-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/ce99db54-4d59-4864-bbc8-cd4f1a28d18b/iec-60749-32-2002-cor1-2003>